

TP700-H65-9

高导热硅胶垫片

TP700-H65-9是一款高导热性能的材料，双面自粘，与电子组件装配使用时，低压缩力下表现出较低的热阻和较好的电气绝缘特性。在-40℃~150℃可以稳定工作，满足UL94 V-0的阻燃等级要求。



特性和优点

- 导热系数: 7.0W/m.K
- 高导热
- 低压缩应力
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 韧性好易操作

典型应用

- 电压调节模块 (VRMs)
- ASICs和DSPs
- 高导热需求模块
- 高热量BGAs
- CD ROM/DVD ROM
- 网络通信设备

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	淡蓝色	目视
厚度(mm)	0.5~10	ASTM D374
密度(g/cc)	3.3	ASTM D792
硬度(Shore OO)	65	ASTM D2240
重量损失(%)	≤1.0	滤纸吸附@压缩25% 125℃ 48H
耐温范围(℃)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	12	温度 < 40℃避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	> 6.0	ASTM D149
介电常数	7.1	ASTM D150
体积电阻率(Ω.cm)	10 ¹²	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/m-K)	7.0	ISO 22007-2
热阻(℃-in ² /W,20psi@1.0mm)	0.13	ASTM D5470